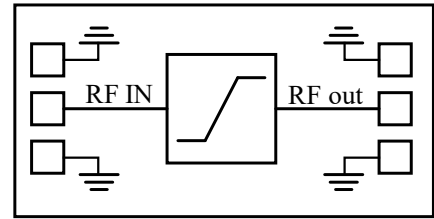


性能特点

- 频率范围：DC~20GHz
- 限幅电平：16 dBm
- 耐受功率：6 W
- 插入损耗：0.3dB
- 芯片尺寸：1.6x0.65x0.1 mm
- 100%在片测试

功能框图



产品介绍

ZXA6304 是一款砷化镓限幅器芯片 (Die)，频率范围覆盖为DC~20GHz，插入损耗0.3dB，限幅电平16dBm。该芯片主要应用于微波电路、测试测量、仪器仪表、雷达和电子对抗。芯片100%射频测试。芯片背面进行了金属化处理,适用于共晶焊接或导电胶粘接工艺。

电气性能参数 (TA = +25℃)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	DC		20	GHz
插入损耗	-	0.3	-	dB
限幅电平	-	16	-	dBm
耐受功率	-	6	-	W
端口驻波	-	1.2	-	

使用限制参数

项目	数值
最高输入功率	+38 dBm (CW)
工作温度	-55 ~ +125 ℃
储存温度	-65 ~ +150 ℃

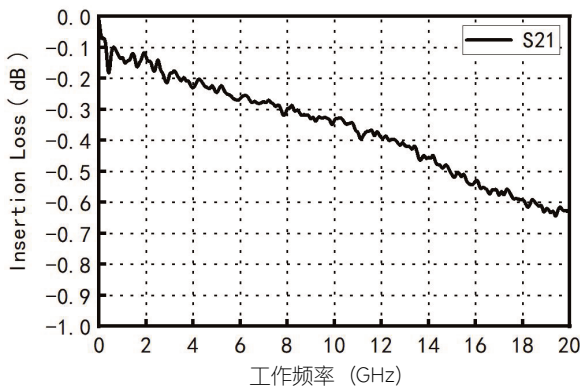
*超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏



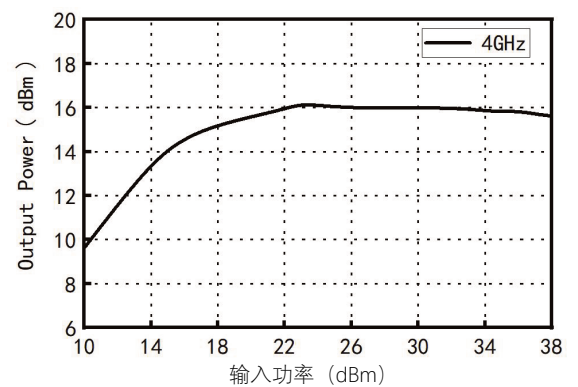
该产品对静电较敏感
使用中请注意防静电

典型测试曲线

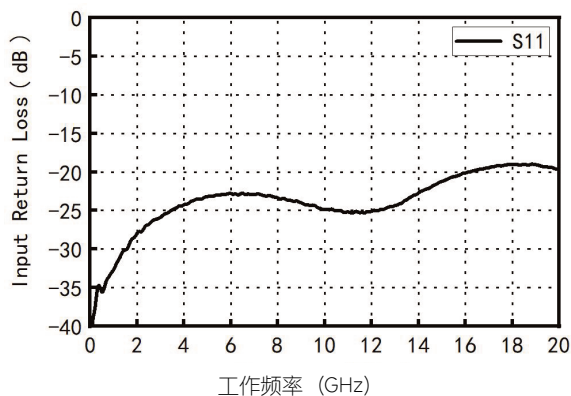
插入损耗 VS 频率



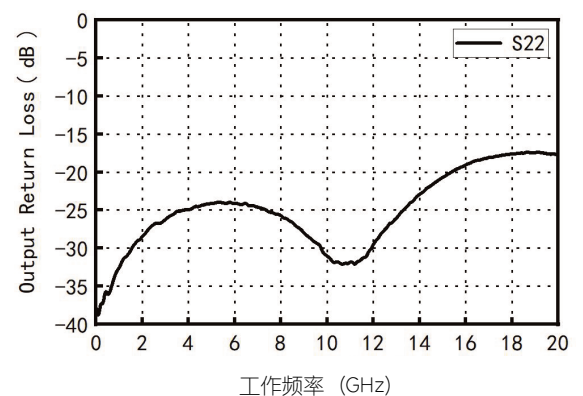
限幅电平 VS 频率



输入驻波 VS 频率

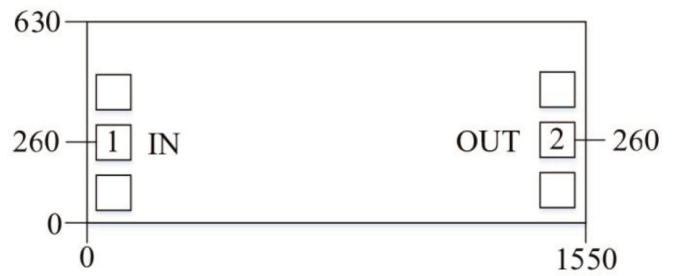


输出驻波 VS 频率



键合点定义

管脚	名称	描述
1	RF IN	射频信号输入端，需外加隔直电容
2	RF OUT	射频信号输出端，需外加隔直电容
芯片底部	GND	芯片底部需要与射频及直流接地良好



说明

1. 单位: μm
2. 键合压点尺寸: $100\mu\text{m} \times 120\mu\text{m}$
3. 芯片背面镀金接地 $\pm 50\mu\text{m}$
4. 外形尺寸公差: $\pm 50\mu\text{m}$

装配示意图

装配说明:

1. 芯片射频端口无隔直功能，需根据实际使用频段选择合适的隔直电容；
2. 使用时，需在驱动电源压点附近加滤波电容到地；芯片背面必须接地。
3. 在净化环境装配使用，不要碰触表面，以免损伤芯片；
4. 输入输出使用2根金丝键合（直径 $25\mu\text{m}$ ），键合线尽量短，不要长于 $400\mu\text{m}$ 。
5. 用Au80Sn20 金锡烧结，温度不要超过 300°C ，烧结时间不要超过 30 秒。
6. 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电。
7. 干燥、氮气环境下保存。

